

[新闻稿] 【2026年4月16日】

广瀨电机发布符合 COM-HPC®标准的 BGA 夹层连接器 “IT18” ~以高速、高密度、高可靠性技术，赋能 AI 时代发展~

COM-HPC®是 PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group)正在推进的新标准之一。PICMG 是一家拥有 25 年以上嵌入式计算经验的联盟，已发布超过 50 项标准。



人工智能技术的快速发展正引领工业设备行业进入重大变革期，包括从云端向边缘计算的转变。随着边缘计算 AI 推理的重要性不断提升，COM-HPC®模块的导入需求正在急剧扩大。为满足这一需求，广瀨电机推出了具备高可靠性及高速性能的新产品 “IT18” 系列。

应用场景设想示例：

工业电脑、工业机器人、人形机器人、AGV/AMR、医疗器械、测量仪器、半导体制造装置、广播设备、游戏机等

● 以高可靠性和高速性能，支持设备技术迭代

近年来，AI 技术迭代加速，生成式 AI 的广泛应用与推理精度的显著提升，正推动工业设备行业迎来重大变革。其中，边缘计算处理能力不仅与云端同步发展，更在实时响应与数据安全方面展现出其优势，使边缘侧 AI 推理的重要性日益突显。为支撑边缘侧的高性能化进程，COM-HPC®模块的导入需求正呈现爆发式增长。

为应对技术演进，广瀨电机开发并发布了符合 COM-HPC®标准，兼具高可靠性和高速性能的新产品 “IT18” 系列。IT18 系列采用 0.635mm 的窄间距、小直径 BGA，通过 Pin-in-Ball 方式实现高可靠性焊接，同时支持卓越的高速性能和高密度信号配置。此外，通过调整列间距，确保充足的走线空间，并通过增加接地过孔 (GND via) 抑制串扰。此外，IT18 通过增加补强金具防止焊球开裂，强化结构坚固性。通过金属防尘盖的设计，可防止产品在加热过程中的变形，并保护其免受周围飞溅的异物影响。IT18 系列助力符合 COM-HPC®标准的各类工业设备的性能提升。

【媒体咨询】

Hirose Electric Co.,Ltd. 全球营销部促销部门

E-mail: hrs.pr.2t@hirose-gl.com

● “IT18” 系列的特征

1. 符合 COM-HPC® 标准的连接器 (Weld tab 版)
2. 支持高速传输
 - PCIe Gen5(32GT/s)、Gen6(64GT/s PAM4)、100Gbps Ethernet (4×25Gbps)
3. 低高度
 - 堆叠高度 5mm、10mm
4. 多芯数,高密度
 - 400 芯 (0.635mm 间距)
5. 开放式引脚区域设计,可应对各种结构设计
6. 采用高实装可靠性的 BGA 结构(Pin-in-Ball)
7. Samtec 公司「COM-HPC® Connector」正式授权产品

● 今后的产品计划

作为广濑电机推出的全新产品系列——后续计划研发符合 COM-HPC®标准的无焊球产品。广濑电机将持续创新，满足客户多样化需求，并为工业设备的技术进化提供支持

● 公司简介、相关信息

■ 公司概况

<https://www.hirose.com/cn/>

■ 产品系列页面

<https://www.hirose.com/zh/product/series/IT18/>

■ 产品图片

<https://prd-4s-public.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/sys-master/public/h8a/h1e/9854934646814/IT18-series-connector-front-view.png>

【媒体咨询】